产品简介

CE5132H 是一款高性能导电粘合剂，低温固化，低应力，高粘结强度。适用于对温度敏感芯片材料的粘接。

典型用途

主要应用于半导体芯片导电粘接。

固化前特性

	典型值	范围	测试标准
外观	银色		
化学类型	环氧树脂		
粘度(mPa.s) (Brookfield HB)			
CP51, 5rpm	10000		GB/T 2794-1995
室温使用期（小时@25℃）	24		

推荐固化条件

在 80℃的条件下，需要 60 分钟固化。

在 120℃的条件下，需要 10 分钟固化。

胶水在受热的状态下会加快反应并固化，固化的速度和强度取决于加热的温度和时间，温度越高固化所需要的时间越短。要根据加热设备的加热效率和被粘接材料适当的调节加热的温度和时间，以得到最佳的工艺参数。

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907

固化后材料的特性

	典型值	测试标准
玻璃转化温度(℃)(TMA)	110	ASTM E1545
热膨胀系数		GB/T 1036-1989
α1 (PPM/℃)	54	
α2 (PPM/℃)	162	
固化失重(%)	0.7	GB/T 1034-1998
导热系数 （W/m-k)	1	
离子含量(ppm)		
Cl -	< 30	
K +	< 20	
Na +	< 20	
拉伸模量，DMA		
@25℃	N/mm2 4600	
	（psi） （667,173）	
@100℃	N/mm2 1200	
	（psi） （174,045）	
@250℃	N/mm2 150	
	（psi） （21,755）	

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907

芯片剪切强度

2X2mm, 硅片/玻璃，kg-f/die:

(80 度 60 分钟固化)

金	16
不锈钢	15.5
银	16

电性能

体积电阻率, Ω·cm	0.0002

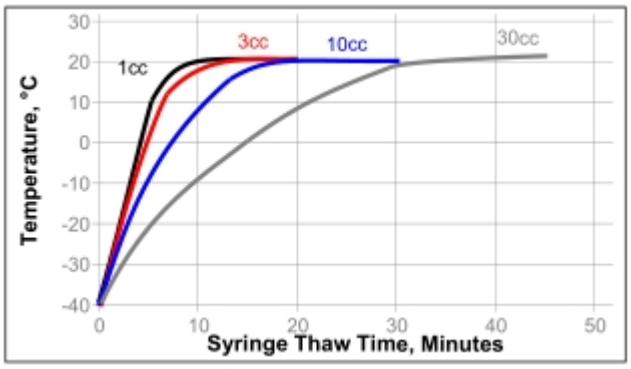
回温

1. 在使用前必须恢复到室温.

2. 胶水从冰柜取出后，垂直放置回温。

3. 回温到 25℃前不允许打开容器，打开容器前需擦净容器表面的湿气。

4. 未用完的胶水，不允许重复冷冻。



声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907

使用说明

1. 回温后的胶水立即放到点胶机上使用。

2. 回温后的胶水必须在操作时间内用完。

注意事项

请远离儿童存放。

本品建议在通风良好的场所内使用。

若不慎沾到皮肤上，请马上用肥皂水清洗。

若不慎沾到眼睛上，请先用大量的水清洗，然后就医。

详细内容请参阅本品的 MSDS。

包装规格

10cc /支

贮存条件

产品密封，在-40℃洁净、干燥处贮存。

贮存期：6 个月

声明：该说明书真实可靠。其中数据仅可作为参考。对于任何人使用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。如果客户使用了本说明书未提及的使用方法，造成的后果应由客户自己负责。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。客户应该对产品是否适用于使用要求负责。烟台长盈公司明确声明对任何必然的或意外损失包括利润方面的损失都不承担责任

烟台长盈电子科技有限公司

地址：山东.烟台经济技术开发区珠江路 60 号

电话：0535-6105906 传真：0535-6105907